

SiMa.aiは、フィジカルAI分野をリードする企業です。高性能・低消費電力・使いやすさを兼ね備えたソフトウェア中心のプラットフォームにより、ロボティクス、自動車、ドローン、産業オートメーション、スマートビジョン、ヘルスケア、防衛など幅広い分野で、高精度・低遅延なAI推論を実現します。ハードウェアとソフトウェアを最適化することで、モデル開発から実運用までの期間を大幅に短縮します。

■ 会社概要

【会社名】 SiMa Technologies, Inc.
【設立】 2018年

【本社】 アメリカ合衆国
【Webサイト】 <https://sima.ai/>

■ 製品情報

MLSoC Modalix (第二世代)	製品の特長
MLSoC Modalix 	デバイス (SoC) SoCにオリジナル機械学習アクセラレータ (Machine Learning Accelerator : MLA) を搭載し、アプリケーション制御、50TOPSの処理を低電力で実現します。 MLSoC Modalixは、CNNに加えTransformer/LLM/LMM/生成AIを低電力 (10W以下) で実行します。 ARMベースのアプリケーションプロセッサを搭載しアプリケーション処理までワンチップで実現可能です。
SoM (System-on-Module) PCIe HHHL 	プロダクションボード データセンターのサーバーや産業/商用PC等のエッジを強化するためのボードで、標準的な作業負荷で10~15Wの低消費電力を実現します。 MLSoC ModalixのSystem-on-Moduleは、産業ロボット、ドローン、自動運転、スマートカメラなどのフィジカルAI向けに、数時間で実装・展開できる高効率なコンピューティングプラットフォームです。
	開発ツール フィジカルAIアプリケーション開発を一新する、次世代統合開発環境です。 Claude CodeとCodex2つの自然言語Agentic AIを活用し、Palette NEATをリンクすることで実装コードを自動生成し、AIモデルの最適化からアプリケーション開発、デプロイまでの全工程をシームレスに一元化します。これまで数か月を要していた開発期間を、わずか数日・数時間へと劇的に短縮。高性能・低消費電力なPhysical AIシステムを、かつてないスピードで実現します。
MLSoC Modalix Development Kit 3.0 	開発キット MLSoCをベースにSoMを搭載したエッジAI向け開発キットです。 高い演算性能と電力効率を両立し、Vision、Generative AI、Sensor Fusionなど多様なワークロードに対応。 モデル最適化から実機評価までを一貫して行えます。 開発キットには、ソフトウェア、ケーブル、電源が含まれております。

■ アプリケーション例



ロボティクス



自動車



ドローン



産業
オートメーション



スマートビジョン



ヘルスケア



航空宇宙・防衛

